

## KLA 推出突破性的電子束缺陷檢測系統

加利福尼亞州米爾皮塔斯市，2020 年 7 月 20 日 /- KLA 公司 ( 納斯達克股票代碼：KLAC ) 今天宣布推出具有革命性的 **eSL10™ 電子束圖案化晶圓缺陷檢測系統**。該新系統旨在通過檢測來發現光學或其他電子束缺陷檢測系統無法穩定偵測的缺陷，加快高性能邏輯和記憶體晶片 ( 其中包括那些依賴於極紫外線 ( EUV ) 光刻技術的晶片 ) 的上市時間。eSL10 採用全新設計，採用了多年研發的多項突破性技術，可提供高分辨和高速的缺陷檢測，其性能是市場中任何其他電子束系統都無法比擬的。

“因其採用單一的高電流密度電子束，eSL10 系統將電子束檢測性能提高到了一個全新的水平。” KLA 電子束部門總經理 Amir Azordegan 表示：“在此之前，電子束檢測系統僅能提使用者選擇偵測供靈敏度或速度，這嚴重限制了其實際應用。我們傑出的工程團隊採用了全新的電子束架構和演算法，設計出一套新系統可以解決現有檢測儀無法解決的問題。今天，KLA 將新型電子束檢測儀成為尖端器件製造中至關重要的設備之一。”

**eSL10 電子束檢測系統**採用多項革命性技術，使其有能力填補目前關鍵缺陷檢測的空白。獨特的電子光學設計可提供業內最廣泛的操作範圍，可捕獲各種設備製程中的缺陷。

Yellowstone™ 掃描模式在每次掃描中收集 100 億像素的資料並支持高速運算同時又不會影響分辨率，這樣可以在廣闊的區域內有效地計算偵測可疑熱點或發現缺陷。Simul-6™ 傳感器技術通過一次掃描即可收集表面、形貌、材料對比度和溝槽深度等信息，從而減少了在具有挑戰性的結構和材料中識別不同缺陷類型所需的時間。憑藉其**先進人工智能 (AI) 系統**，eSL10 採用深度學習演算法，可針對 IC 製造商不斷發展的檢測要求進行調整，並將產品性能最關鍵的缺陷分離出來。

三維產品架構中，例如用於記憶體的 3D NAND 和 DRAM，以及用於邏輯的 finFET 和閘極全環 ( GAA ) 晶體管，使得晶圓廠需要重新考慮傳統的缺陷控制策略。eSL10 與 KLA 的旗艦 39xx ( “Gen5” ) 和 29xx ( “Gen4” ) 寬帶光學晶片缺陷檢測系統相結合，為先進 IC 技術提供了強大的缺陷檢測和監控解決方案。這些系統結合可以提高良率和可靠性、更快發現關鍵缺陷，並能夠更快地解決從研發到生產的缺陷問題。



新的 eSL10 架構內置可擴充性，可以在整個電子束檢測和量測領域內延伸其應用。全球已有領先的邏輯、記憶體和代工製造商採用 eSL10 系統，並用於協助開發、提升和監測新一代製程和產品製造。為了保持其高性能和生產力，eSL10 系統由 [KLA 全球綜合服務網絡](#) 提供支持。有關新的電子束缺陷檢測系統的其他信息，請參見 [eSL10 產品頁面](#)。

#### **關於 KLA：**

KLA 公司致力於開發領先業界的設備與服務，支持整個電子產業的創新。我們為晶圓和光罩製造、積體電路、封裝、印刷電路板和平面顯示提供先進的製程控制解決方案。我們的物理學家、工程師、資訊工程師和問題解決專員組成專家團隊，與全球領先的客戶密切合作，並共同設計推動世界前進的解決方案。更多相關信息，請訪問公司網站

[kla.com](http://kla.com)(KLAC-P)。

#### **展望性聲明:**

本新聞稿中除歷史事實以外的聲明，例如關於 eSL10、295x 和 39xx 系統的預期性能和缺陷減少，及其為晶圓、設備、eSL10、材料和晶片製造設施所帶來的經濟影響都是展望性陳述，並且並符合《1995 年美國私人證券訴訟改革法案》（ Private Securities Litigation Reform Act of 1995 ）中“安全港”（Safe Harbor）條款的規定。這些展望性聲明基於目前資訊及預期，並且受到諸多風險與不確定性影響。由於各種實際因素，例如（由於成本、性能抑或其他原因造成的）新技術推遲、其他公司推出競爭性產品、或影響 KLA 產品的實施、性能或使用的意外技術挑戰或限制等影響，實際結果可能與此類聲明中的預計結果大不相同。

#### **來源 KLA 公司**

投資者關係: Kevin Kessel, CFA, 投資者關係副總裁 (408) 875-6627, [kevin.kessel@kla.com](mailto:kevin.kessel@kla.com); 媒體關係: Randi Polanich, 通訊主任及副總裁, (408) 875-6633, [randi.polanich@kla.com](mailto:randi.polanich@kla.com)